

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司

### 关于签署《临时债委会协议》补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要事项及风险提示：**

- 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于近日收到了经原临时债委会全体成员单位共同签署《临时债委会协议》补充协议，该补充协议为《临时债委会协议》之延续。该补充协议生效后，临时债委会有效期变更为自 2025 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 7 日。
- 根据《临时债委会协议》补充协议特别约定，若瀚川智能经营状况发生重大变化，经临时债委会表决通过，可提前终止或延长临时债委会协议。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **一、签署《临时债委会协议》补充协议的具体情况**

为持续防范和化解公司及其关联企业的债务风险，维护全体金融机构债权人合法权益，2025 年 11 月 6 日，经临时债委会全体成员表决通过，决定将原临时债委会延期 6 个月，自 2025 年 11 月 8 日至 2026 年 5 月 7 日。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于未能按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的进展公告》（公告编号：2025-089）。

近日，公司收到了由原临时债委会全体成员单位共同签署完毕的《临时债委会协议》补充协议，除补充协议另有规定外，原协议所有条款继续有效。该补充协议为《临时债委会协议》之延续。该补充协议生效后，临时债委会有效期变更为自 2025 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 7 日。

该补充协议中补充明确融资压降计划，根据瀚川智能目前经营性现金流、应

收账款收回、资产处置变现及后续新进增资等，逐步归还临时债委会各债权行融资。截至 2025 年 9 月 30 日，11 家债权行融资余额合计约 10.72 亿元。双方达成共识，根据融资压降计划，瀚川智能于 2025 年 11 月底前归还临时债委会不低于 1,000 万元融资；2025 年 12 月底前归还临时债委会不低于 4,000 万元融资，并根据企业预计现金流情况排定 2026 年全年不低于 1.5 亿元的还款计划。

截至本公告披露日，瀚川智能已按时完成上述 2025 年 11 月份压降计划。

## 二、风险提示

根据《临时债委会协议》补充协议特别约定，若瀚川智能经营状况发生重大变化，经临时债委会表决通过，可提前终止或延长临时债委会协议。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日